

半导体成熟技术推动智能生活

如今，智能生活离我们越来越近，在物联网时代下，超越摩尔的半导体成熟技术推动的智能城市、智能家居，智能电网、智能汽车以及下一代可穿戴技术等应用越来越广，给半导体厂商带来越来越多的机遇。

智能应用软件和云的同时，更重要的一环是需要半导体芯片和半导体器件的支持，可以想象，未来的物联网世界需要极巨大数量的传感器，MCU、MEMS等成熟技术的半导体工艺为智能生活提供了技术支持。在半导体封装工艺方面，3DIC、TSV等先进工艺的不断也将推动着智能生活的进步。日前，在西安市高新开发区管委会大力支持下，聚焦3DIC标，SEMI中国封测委员会第五次会议在西安成功召开，SEMI全球副总裁、中国区总裁陆郝安与西安高新开发区安主任共同为会议致辞，吴凯代表SEMI中国同与会者分享了中国半导体及封测市场现状、SEMI标准制定流程和重要意义、SEMI标准在北美的成功案例等主题报告。

会上，经过热烈讨论，代表们就3DIC标准的制订在几个方面达成共识，一是台湾和北美对3DIC发展方向也不明确，中国半导体投资巨大且贴近应用市场，有机会赶上欧美先进水平，甚至在特定领域可实现“弯道超车”；二是3DIC会是一个由应用来驱动的市场，参与者要找到合适自己的细分市场、贴近应用，无需盲目跟随国际大厂高端技术；三是标准能推动3DIC技术市场化，但3DIC的标准不仅仅在制造，还应包括测试和DFM环节；四是3DIC标准不能局限于高端，基于本土服务好细分市场，同时通过SEMI这个全球性平台推向国际市场才是可行之道；五是“低成本TSV”技术是3DIC大规模应用的关键，对中国本土企业尤其重要，本土的Foundry和封测厂应该重点突破这个领域；六是良率、设计优化、测试、衬底材料创新等对实现3DIC量产至关重要，预计Memory 3DIC在2015左右进入规模量产；七是SEMI中国封测委员会成员覆盖整个产业链，是个在战略、市场、标准等层面上能提供的独特交流平台。

SEMI中国总裁陆郝安指出，SEMI封测委员会成员覆盖整个产业链，从材料、设备、代工厂到设计、封测、系统公司，在解决大家共同关心问题上，如高效率制定标准推动3DIC发展并通过SEMI推向国际等方面具有特殊价值。

与会代表们认为，标准很重要，不仅要学习标准、还要参与标准、更要善用标准。基于此，借鉴2011年成立的SEMI光伏委员会迄今已有3条成为国际光伏标准的成功案例，封测委员会第六次会议将会在明年元月召开，具体讨论低成本TSV标准及技术路线图的制订流程。另外，来自西安高新区投资促进局、陕西省工信厅、西安高新区管委会的政府领导与三星中国半导体、中兴通讯为代表的企业界嘉宾，也就如何发展西安半导体产业的话题同封测委员会的专家们进行了热烈探讨。

SEMICON China 2014展会的智能生活专区将展示最新的物联网应用技术，更多与智能生活相关的，将物联网应用与半导体技术紧密结合。在物联网时代，云计算、大数据分析都将是热门的话题，实现智能生活，需要产业界的共同协作，需要更多半导体厂商参与其中，提供技术和硬件的支持，如在智能汽车传感器、移动设备和智能手机芯片、智能医疗设备的低功耗解决方案以及智能家居楼宇自动化的实现。

因此，在SEMICON China 2014展会期间，在展馆展示智能生活专区的同时，举办“超越摩尔”技术论坛的目的正是为促进产业交流和发展，论坛将邀请到产业内各个领域的技术专家、产业领袖和投资商，他们将在论坛上分享成功经验，共同探讨技术路线。从软件到硬件，从设计到应用，共同探讨如何将成熟的超越摩尔相关技术更多应用于物联网构建的智能生活中。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_55476.html